

3-5176264-2 ✓ AKTIV

AMPMODU | AMPMODU 2 mm

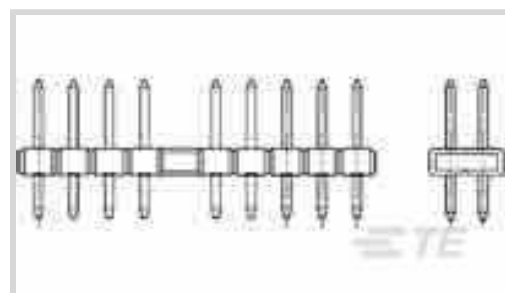
Interne TE-Nummer 3-5176264-2

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 36 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Unshrouded, Gold, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU 2 mm

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **36**

Zeilenanzahl: **2**

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Ohne Umhüllung
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Nein
Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	36
Zeilenanzahl	2
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	650 VAC
Arbeitsspannung	200 VAC

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Schwarz
----------------------	---------

Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	4 mm[.158 in]
Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.5 mm[.02 in]
	78.74 µin
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Messing
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.203 µm[8 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	1 A

Klemmenmerkmale

Runder Endverschluss, Anschlussstift- und Restdurchmesser	.6 mm[.024 in]
Anschlussstift- und Restlänge	2.6 mm[.102 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anslusstechnik

Gegensteckführung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	2 mm[.079 in]
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast

Abmessungen

Steckverbinderhöhe	1.75 mm[44.45 in]
Reihenabstand	2 mm[.079 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.6 mm[.063 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	8000
Verpackungs-Typ	Rolle

Weitere

Ausgelassene Positionen	0
-------------------------	---

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Auch serienmäßig | **AMPMODU 2 mm**



Kabel-an-Leiterplatte-
Steckverbinderkontakte(27)



Kabel-an-Leiterplatte-
Steckverbindersätze und -gehäuse(109)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen
(9602)

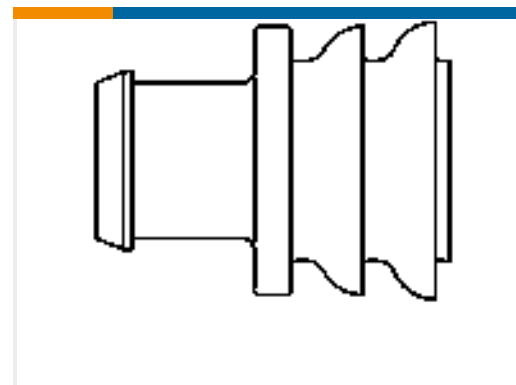
Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM,
STECKVERBINDERGEHÄUSE



TE Teilnr.:206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE Teilnr.:281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE Teilnr.:DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE Teilnr.:W2S
DEUTSCH DT Keilschlösser



TE Teilnr.:0460-202-16141
DEUTSCH Kontakte



TE Teilnr.:DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

Dokumente

Produktzeichnungen

36 AMPMODU 2MM DR VERT MNT LF

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_3-5176264-2_O1.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_3-5176264-2_O1.3d_stp.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_3-5176264-2_O1.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.



[Datenblätter/ Katalogseiten](#)

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4](#)

Englisch